证券代码： 300782 证券简称：卓胜微

**江苏卓胜微电子股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 ■其他 （电话会议） |
| 参与单位名称 | 参会单位：（以下排名不分先后）广发电子、国君自营、阳光保险、光大证券、中证焦桐、华润元大基金、中邮基金、东海资管、国金证券、安信电子、国元电子、中邮证券、善道投资、凯岩资本、华西电子、东兴证券、华金证券、尊道投资、大朴资产、汇丰证券、悟空投资、摩根华鑫、CGS、CSC、泓盛资产、民生电子、西南证券、彤源投资、华泰新产业基金、北京泽铭投资有限公司、上银基金、理成资产、中金公司、银华基金、中金基金、上海富善、海通电子、盛宇基金、国盛电子、润晖投资、上海东涵通讯科技有限公司、中睿合银、景顺长城、汇蠡投资、华泰柏瑞基金、汇安基金、金鹰基金、首创证券、石峰资产、韩国投资、智诚海威、鸿盛资产、恒生前海、景领投资、嘉实基金、永瑞财富、龙远投资、上海彬元、安信资管、申万电子、华泰保兴基金、新时代电子、台湾富邦人寿、国寿资产、国投瑞银、工银瑞信、长信基金、交银基金、永赢基金、诺德基金、中加基金、易鑫安资管、爱建证券、首创证券自营、兴银基金、国金基金、基石资本、圆信永丰基金、BMO Global Asset Management、中欧基金、东方证券、诺安基金、中融人寿保险、浦银国际、上投摩根基金、天治基金、光大永明资产、南方基金、中国人寿资产、中银资管、前海鹏泽资管、浦银安盛基金、中银基金、大成基金、天弘基金、仁桥资管、国新投资、兴证全球基金、华安基金、汇添富基金、华泰证券、东吴基金、希瓦资产、建信基金、泰达宏利基金、九泰基金、新华基金、华富基金、中海基金、尼西资本等 |
| 时间 | 2020年9月1日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：FENG CHENHUI（冯晨晖）证券投资部经理：刘丽琼 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. 简要介绍公司经营业绩情况

2020年上半年在新冠疫情，中美贸易摩擦升级，错综复杂的外部环境的影响下，整个公司的业务情况较去年同期还是保持稳健增长的发展趋势，上半年公司实现了营收9.97亿元，同比增长93.64%，归属于母公司股东的净利润3.53亿元，同比增长130.99%。整体毛利率52.64%，较去年同期减少0.28%。一方面，公司抓住5G和国产替代发展机遇，持续加大研发创新投入，不断提升公司核心竞争力，核心技术转化成果显现。另一方面，公司充分发挥在移动终端射频领域的优势，持续推进与客户的深度合作。二、在问答环节，主要回复如下：**1、2020年半年报中提到天线调谐开关销售达到15亿颗，射频开关的营业收入是8.5亿，毛利率为53.37%，其中天线调谐开关的在射频开关营收占比是多少？**答：尊敬的投资者，您好！公司在公告中未对天线调谐开关的营业占比进行量化的披露。随着5G通信应用的普及及对天线效率提升的要求，天线调谐开关的需求量随之快速提升，天线调谐开关在营收中占比逐步增加，已成为公司的拳头产品之一。感谢您对公司的关注！**2、目前与公司合作的Foundry厂具体是哪些？未来与公司合作产线的Foundry厂将是哪一家？**答：尊敬的投资者，您好！公司与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商形成紧密合作，晶圆制造商包括Tower、台积电、台联电、华虹宏力等，公司根据不同的材料和工艺与不同的Foundry厂合作，也在积极同具有相应技术能力和发展潜力的Foundry厂商规划未来合作建设产线的可能性，若项目有进一步进展公司会根据相关规则要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！**3、公司定增项目的预期进展情况怎么样？** 答：尊敬的投资者，您好！公司本次向特定对象发行股票事项已于2020年8月3日收到深圳证券交易所审核问询函，由于问询函内容涉及2020年半年报相关财务数据，公司会同相关中介机构积极对问询函中的相关问题进行逐项落实并会尽快提交回复，项目最终能否通过审核并获得同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！**4、美国对华为的政策是否会影响公司对华为的供货？** 答：尊敬的投资者，您好！目前公司正在认真评估具体相关政策及规定，并相应做出调整。公司将继续密切关注并评估国际相关政策及市场的进一步变化，对政策进行深入研究，对未来市场进行预判和准备，提高公司抗风险能力。感谢您对公司的关注！**5、如果华为手机业务发生变化，是否对公司有很大影响？**答：尊敬的投资者，您好！公司的终端客户群已覆盖了绝大部分安卓手机厂商，如公司客户业务出现变化, 短期内可能会使公司的客户结构出现一定的调整，但长期来看，只要整体安卓手机市场需求没有变化，公司的总体经营和发展不会受到大的影响。感谢您对公司的关注！**6、公司PA产品有什么布局？**答：尊敬的投资者，您好！公司目前已推出WiFi端射频功率放大器产品,该产品以集成在模组中为主要产品形式，主要应用于路由器、手机、平板电脑、笔记本电脑等组网设备和智能终端。感谢您对公司的关注！**7、公司BLE产品未来的发展战略是什么？**答：尊敬的投资者，您好！公司低功耗蓝牙微控制器芯片主要应用于物联网领域。公司将密切关注客户需求的变化并保持沟通，深入拓展智能穿戴、智能家居等低功耗蓝牙微控制器产品应用领域，进一步推进物联网领域产品的市场化进程。感谢您对公司的关注！**8、公司人员新增较快，主要是哪方面的人员新增？** 答：尊敬的投资者，您好！公司新增人才储备主要用于新产品和新技术的研发。公司注重人员效率，充分发挥每位员工的创造力和执行力，从而推动产品的快速高效迭代。随着公司射频前端产品线的不断丰富，公司人才规模也将逐步扩大。感谢您对公司的关注！**9、公司模组产品的开发进展情况具体是什么？**答：尊敬的投资者，您好！目前公司已推出射频滤波器分集接收模组产品（DiFEM）、射频低噪声放大器/滤波器集成模组产品（LFEM）、多通道多模式低噪声放大器模组产品（LNA bank）、WiFi连接模组产品（WiFi & connectivity module），截止2020年上半年，上述模组产品处于小批量试产或量产阶段。公司射频模组产品可满足客户对于不同频段的定制需求。感谢您对公司的关注！**10、分立器件和模组的市场发展趋势是什么？**答：尊敬的投资者，您好！射频前端模组化是未来的发展大趋势，能够在提高集成度的同时保证产品性能。现阶段分立器件在供应链安全和成本上更具优势。根据Yole Development的统计与预测，模组和分立器件将会长期共存，分立器件与射频模组共享整个射频前端市场。2018年射频模组市场规模达到105亿美元，约占射频前端市场总容量的70%；到2025年，射频模组市场将达到177亿美元，年均复合增长率为8%。2018年分立器件市场规模达到45亿美元，约占射频前端市场总容量的30%。到2025年，分立器件仍将保留81亿美元的市场规模。感谢您对公司的关注！ |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年9月1日 |